



联络人

投资人关系

+886 3397 5999 ext. 18683/18684

ir@winfoundry.com

## 稳懋半导体公告 2022 年第三季自结财务报告

---

2022 年 10 月 28 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(28)日公告 2022 年第三季自结财务报告。

### 2022 年第三季财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 39.09 亿元，较前季减少 26%，较去年同期减少 42%
- ◆ 本季合并毛利率为 16.0%，较前季减少 14.2 个百分点
- ◆ 本季营业净利率较前季减少 19.2 个百分点为 -5.1%，营业净损为新台币 2 亿元
- ◆ 本季税后净利为新台币 2.45 亿元，较前季减少 55%，较去年同期减少 84%；每股盈余为新台币 0.83 元，前季为新台币 1.52 元

### 2022 年第四季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 第四季营收预计较前一季下滑 low-teens 百分比。
- ◆ 第四季毛利率预计落在 high-teens 至 low-twenties 区间的水平。

---

### 免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

## 管理者评论

“稳懋第三季合并营收为新台币 39.09 亿元，如之前所预期的较前一季下滑约 26%，较去年同期下滑了 42%，主要是受到安卓(Android)智能型手机市场持续库存调整的影响，产能利用率进一步下滑到 40%的水平。第三季营业毛利率若排除一次性因素后应为 21.1%，主要因以投资为营业目的之合并子公司持有甫于今年挂牌的海外投资标的，因第三季经历全球股市的大幅波动而产生了一次性评价损失，影响毛利率约 5.1 个百分点。也因此第三季合并营业毛利率成为 16%，同时合并营业净利率成为 -5.1%。第三季合并净利为新台币 2.45 亿元，EPS 为新台币 0.83 元。在各项产品组合出货当中，还是以 Cellular PA 及 Wi-Fi PA 等消费性应用产品下滑的幅度最大，除了反映市场过高的库存水位外，也凸显终端消费者对于总体经济下滑的担忧，相对属于工业性应用产品的 Infra 表现虽然不如前一季，但较不受大环境的影响，今年前三季 YoY 始终维持正成长，Optical 产品则因出货旺季而略优于前一季。

尽管短期全球经济景气循环仍处于低迷当中，但是利用率逐渐下滑的晶圆厂产能也提供稳懋客户绝佳的机会，我们看到无论是微波通讯或是光通讯客户都有更积极的研发投片活动，除了现有客户为了明后年的产品而导入稳懋新世代制程进行认证，更有新客户为了未来几年打入新市场或新应用而选择稳懋成为合作伙伴，开启新的合作关系。全球逐渐跨入后疫情时代，我们也感受到越接近年终岁末有越多客户的拜访及新计划的开展，主要着眼于数个终端市场的大趋势，除了 5G 行动通讯的持续渗透及 5G 基础建设的布建之外，光通讯及光感测的生产外包趋势 (Outsourcing Trend) 也正在形成当中，特别的是，客户对于先进制程技术，如 GaN-on-SiC、InP 等第三类半导体材料的兴趣及投入都高过以往。在景气低潮的时候，我们放缓扩充的速度，同时持续积极的投入研发，把握下一道曙光到来的机会。

展望第四季，预计营收将较前一季下滑 low-teens 百分比，预计毛利率落在 high-teens 至 low-twenties 区间的水平。”

---

## 关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英寸晶圆生产砷化镓微波集成电路 (GaAs MMIC) 的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司 (RFIC Design Houses) 外，并致力吸引与全球整合组件制造 (IDM) 大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质接面双极性晶体管 (HBT) 和应变式异质接面高迁移率晶体管 (pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中，稳懋更以 MMIC 生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。